

2024年度 決算説明会資料

2025年5月22日



株式会社 メイコー
(証券コード：6787)

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

1

2024年度実績

2

2025年度予想

3

財務指標と株主還元

4

今後の方針

2024年度 業績

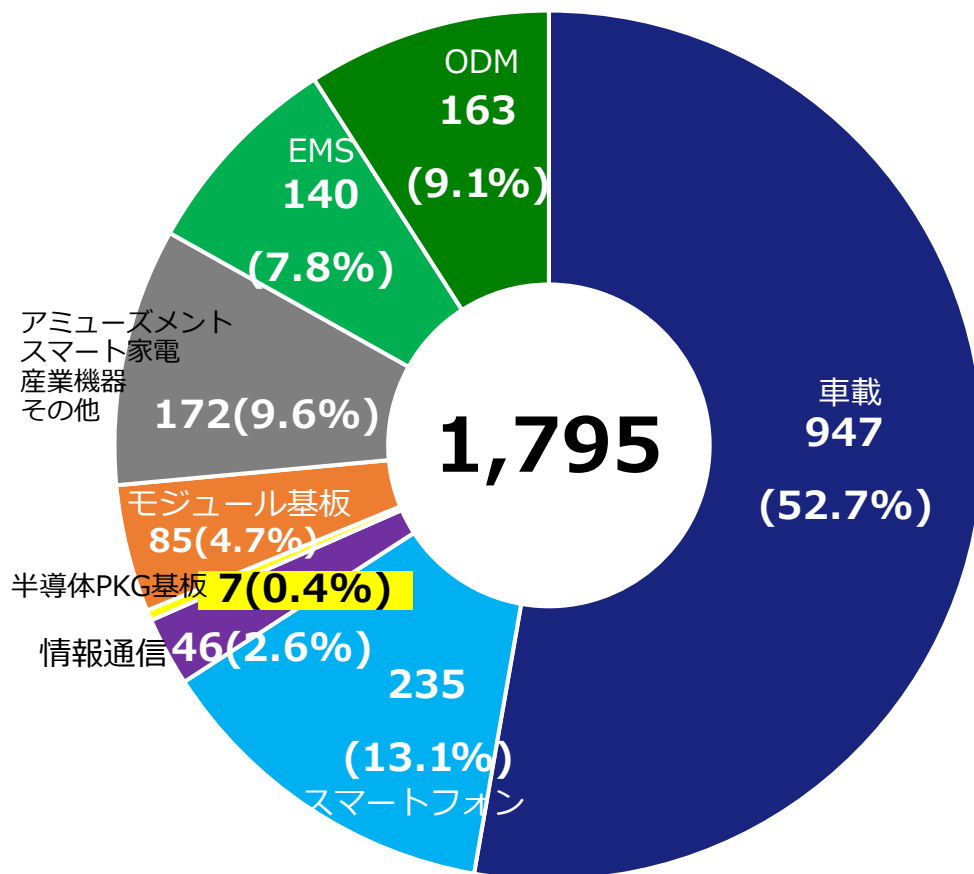
(単位：億円)

		2023年度		2024年度		前期比	
		通期実績	利益率	通期実績	利益率	増減額	増減率
売上高	基板	1,492		1,706		214	14.3%
	電子機器	303		362		59	19.5%
		1,795		2,068		273	15.2%
営業利益	基板	108	7.2%	172	10.1%	64	59.3%
	電子機器	9	3.0%	19	5.2%	10	111.1%
		117	6.5%	191	9.2%	74	63.7%
経常利益		143	8.0%	188	9.1%	45	31.5%
当期純利益		113	6.3%	149	7.2%	36	32.0%
期中平均為替レート (JPY/USD)		145.31		152.57			

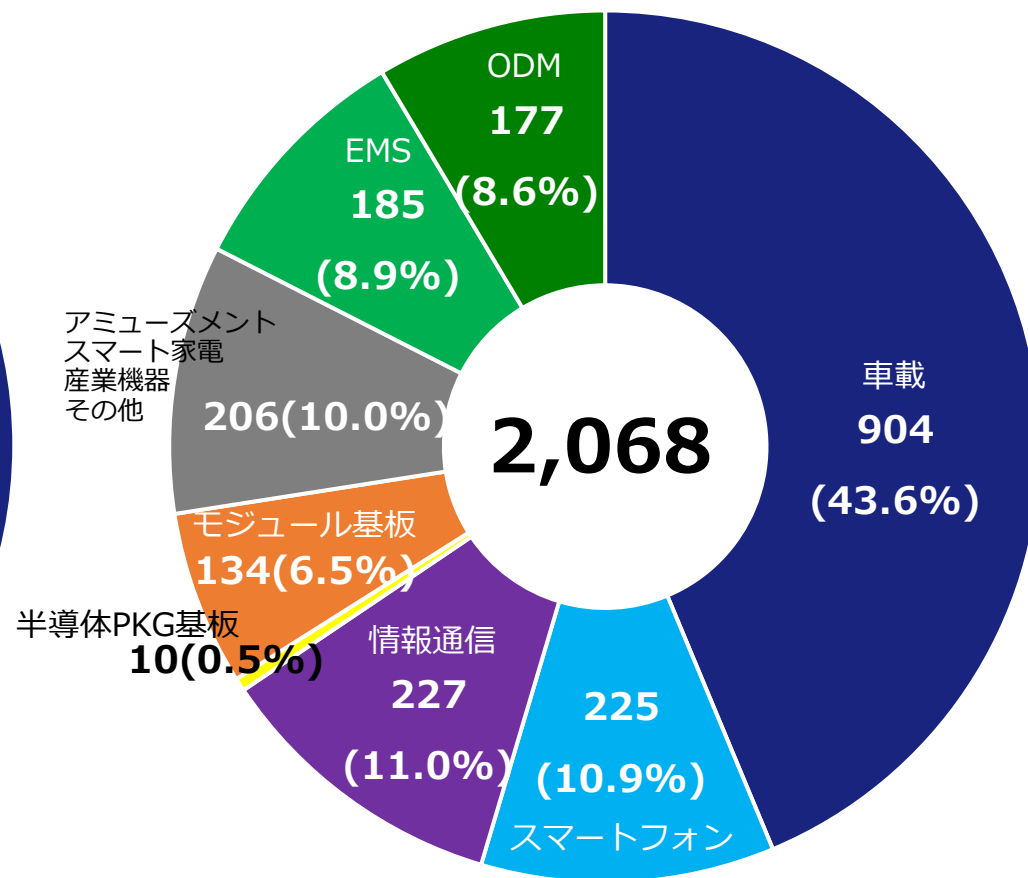
2024年度 商品別実績

(単位：億円)

2023年度実績



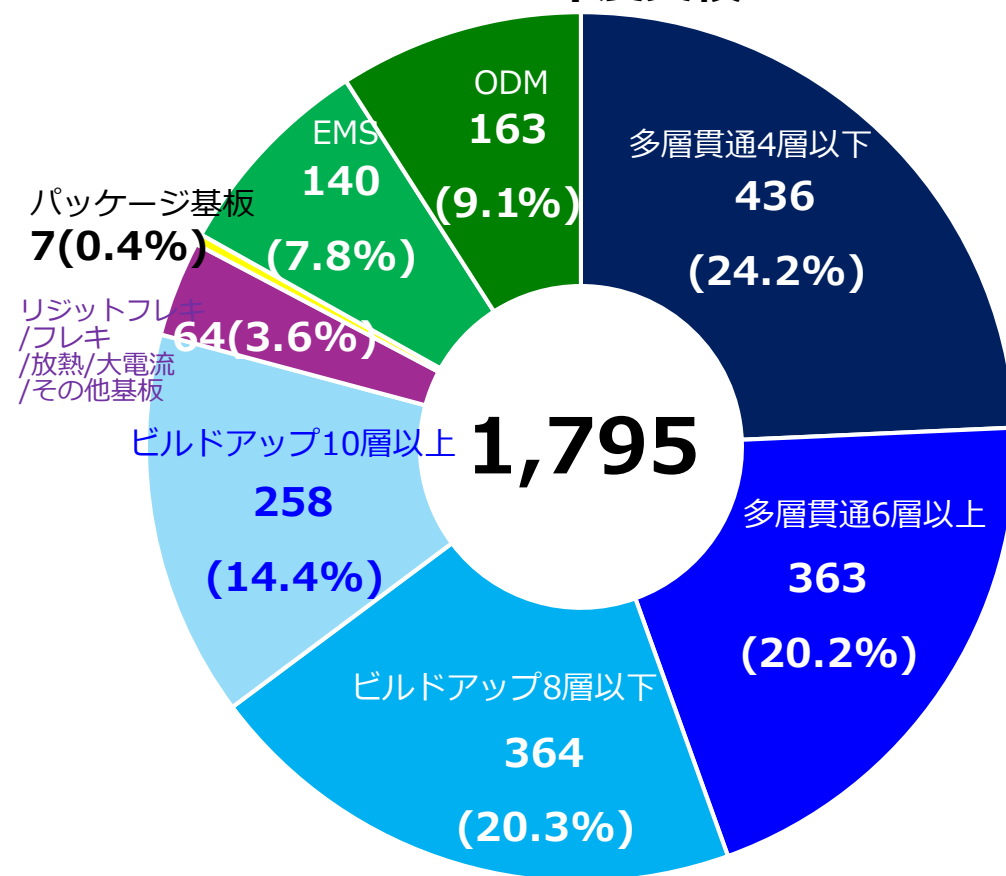
2024年度実績



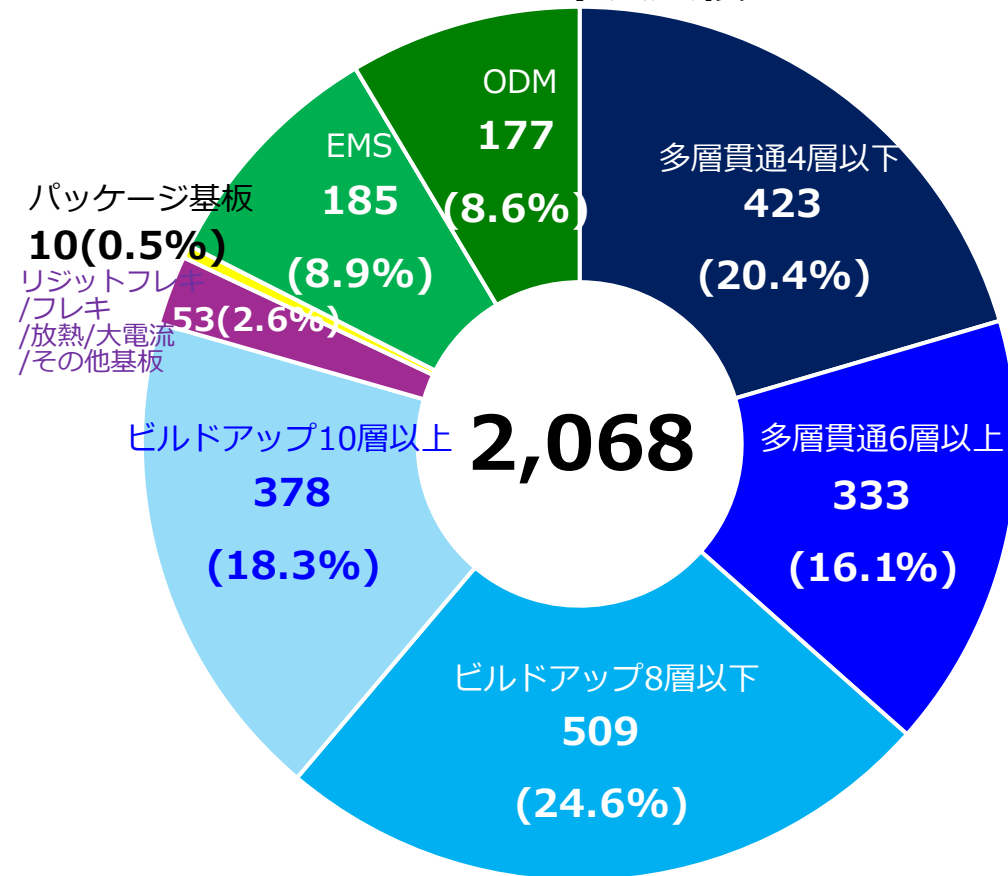
2024年度 仕様別実績

(単位：億円)

2023年度実績



2024年度実績



1

2024年度実績

2

2025年度予想

3

財務指標と株主還元

4

今後の方針

2025年度 業績予想

(単位：億円)

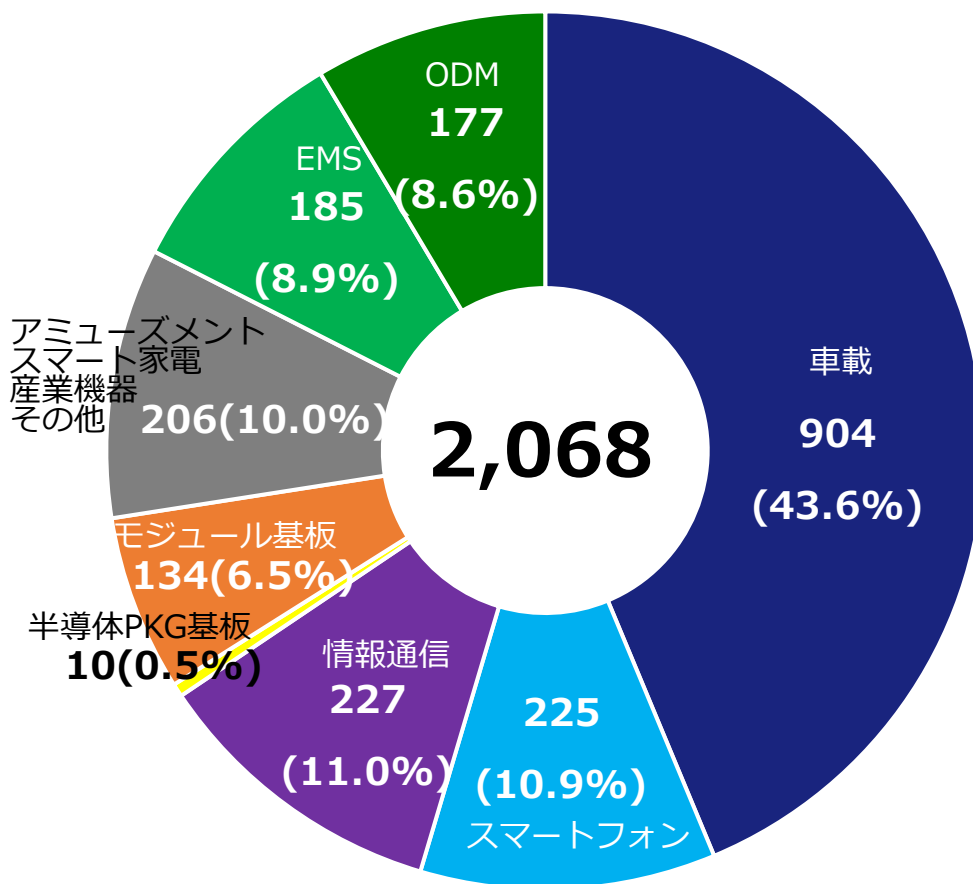
		2024年度		2025年度		前期比	
		通期実績	利益率	通期予想	利益率	増減額	増減率
売上高	基板	1,706		1,740		34	2.0%
	電子機器	362		390		28	7.7%
		2,068		2,130		62	3.0%
営業利益	基板	172	10.1%	177	10.2%	5	2.9%
	電子機器	19	5.2%	23	5.9%	4	21.1%
		191	9.2%	200	9.4%	9	4.8%
経常利益		188	9.1%	190	8.9%	2	1.3%
当期純利益		149	7.2%	155	7.3%	6	3.9%
期中平均為替レート (JPY/USD)		152.57		140			

為替の円高影響（▲120億円）とトランプ関税の景気影響を織り込み

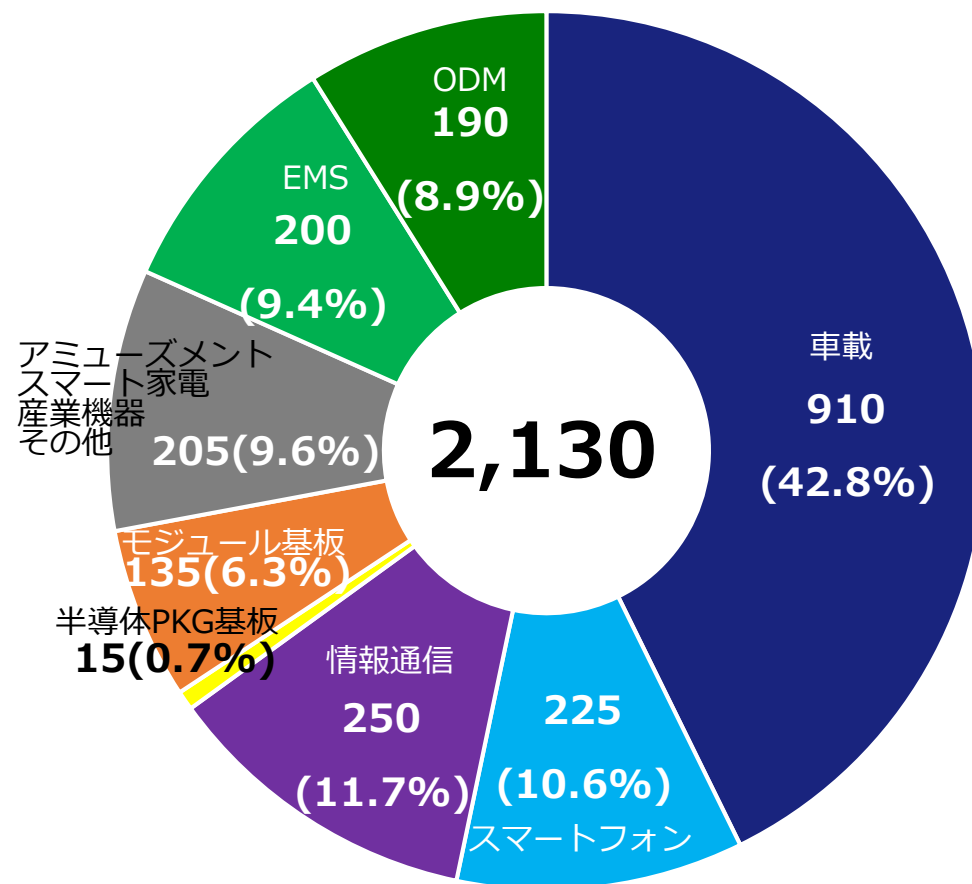
2025年度 商品別予想

(単位：億円)

2024年度実績



2025年度予想

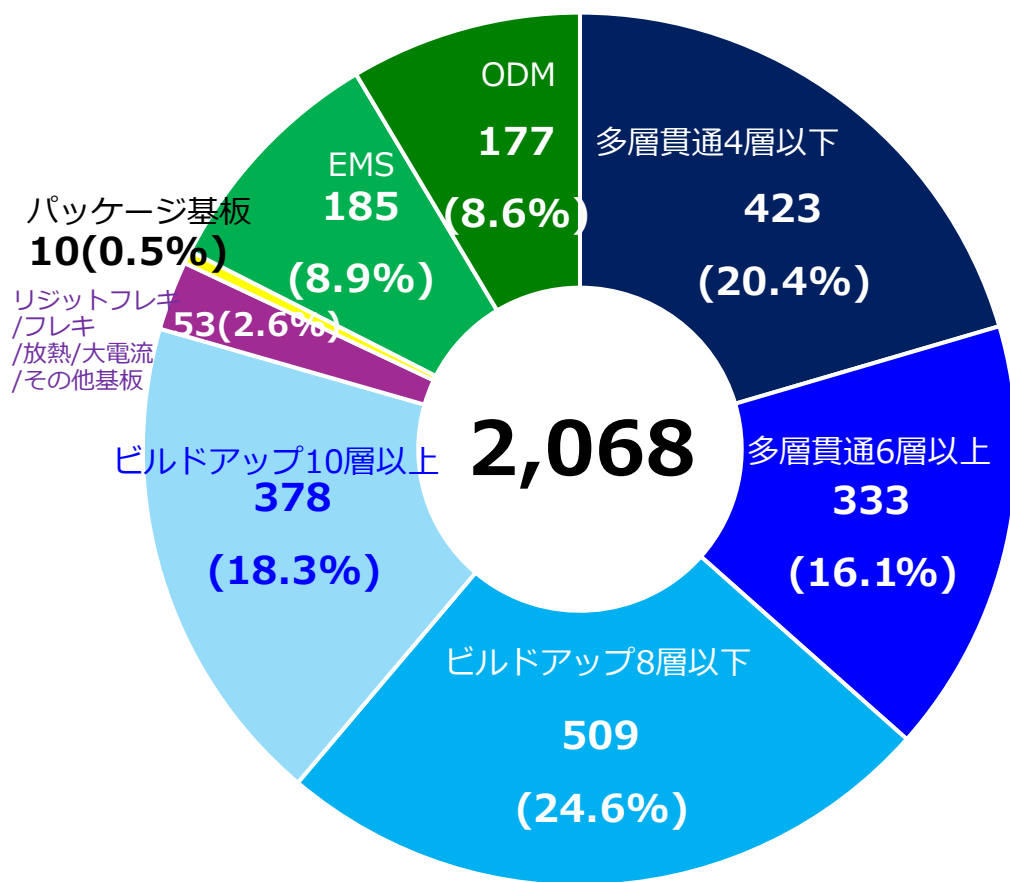


2024年度を底に、全商品で売上高は増加していく

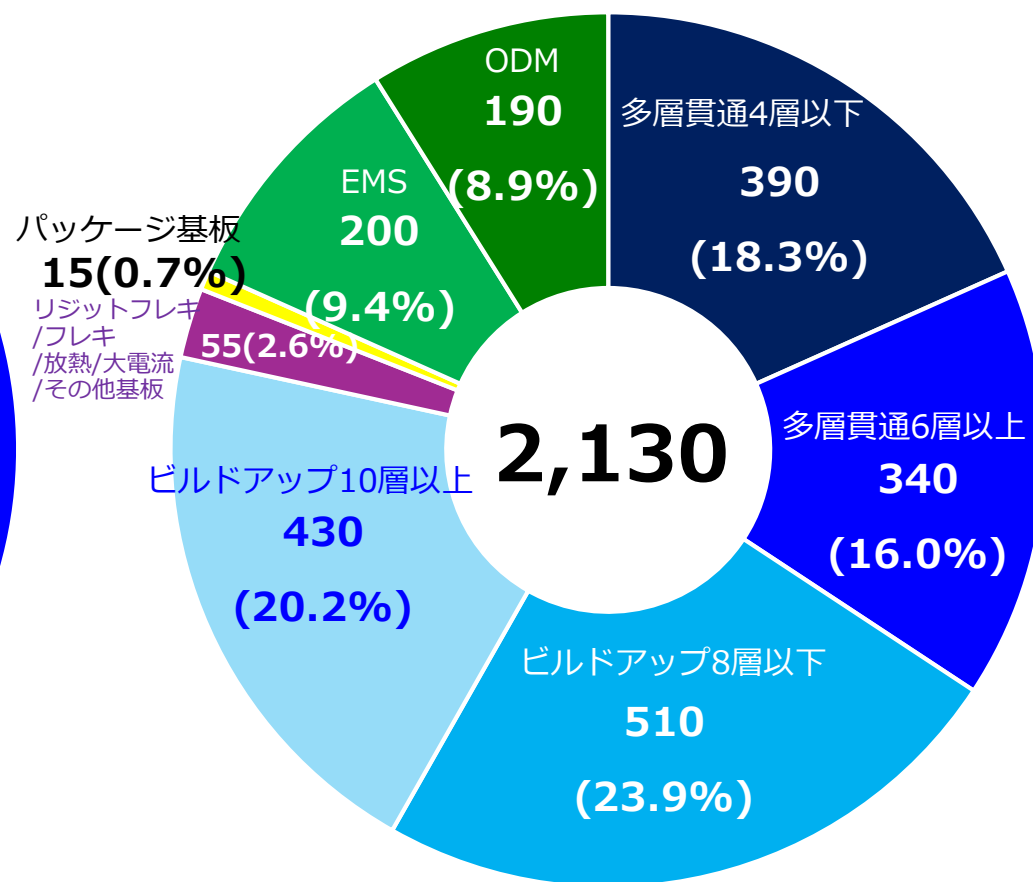
2025年度 仕様別予想

(単位：億円)

2024年度実績



2025年度予想



多層貫通基板以外は、すべての分野で売上高は増加していく

1

2024年度実績

2

2025年度予想

3

財務指標と株主還元

4

今後の方針

財務指標と株主還元

(単位：億円)

1. 設備・研究開発投資を通じ、継続的に売上高・利益を拡大させて行きます。
2. バランスの取れた財務体質の強化を進めて参ります。
3. 連結配当性向は15%を目安とします。
4. 利益を拡大させ、株主価値と配当額の向上に努めます。

	2022年度（実績）	2023年度（実績）	2024年度（実績）	2024年度/2022年度	2025年度（予想）
売上高合計	1,673	1,795	2,068	1.2倍	2,130
営業利益	96	117	191	2.0倍	200
営業利益率	5.7%	6.5%	9.2%	1.6倍	9.4%
経常利益	112	143	188	1.7倍	190
当期純利益	88	113	149	1.7倍	155
投資額	174	199	298	1.7倍	510
研究開発費	45	53	63	1.4倍	65
EBITDA	194	228	316	1.6倍	339
純資産合計	845	1,055	1,156	1.4倍	1,254
有利子負債残高	753	793	868	1.2倍	1,167
自己資本比率	38.2%	42.7%	42.2%	1.1倍	43.5%
D/Eレシオ	0.89	0.75	0.75	0.8倍	0.93
ROE	10.5%	10.7%	12.9%	1.2倍	12.3%
株価	2,922円	5,420円	6,840円	2.3倍	-
時価総額	749	1,390	1,776	2.4倍	-
EPS	338.94円	428.70円	569.47円	1.7倍	591.78円
PER	8.47倍	12.29倍	12.03倍	1.4倍	-
PBR	0.97倍	1.42倍	1.51倍	1.6倍	-
配当額	55円	68円	88円	1.6倍	90円
配当性向	16.2%	15.9%	15.5%	-	15.2%
ドル円為替レート	136.00円	145.31円	152.57円		140円

1

2024年度実績

2

2025年度予想

3

財務指標と株主還元

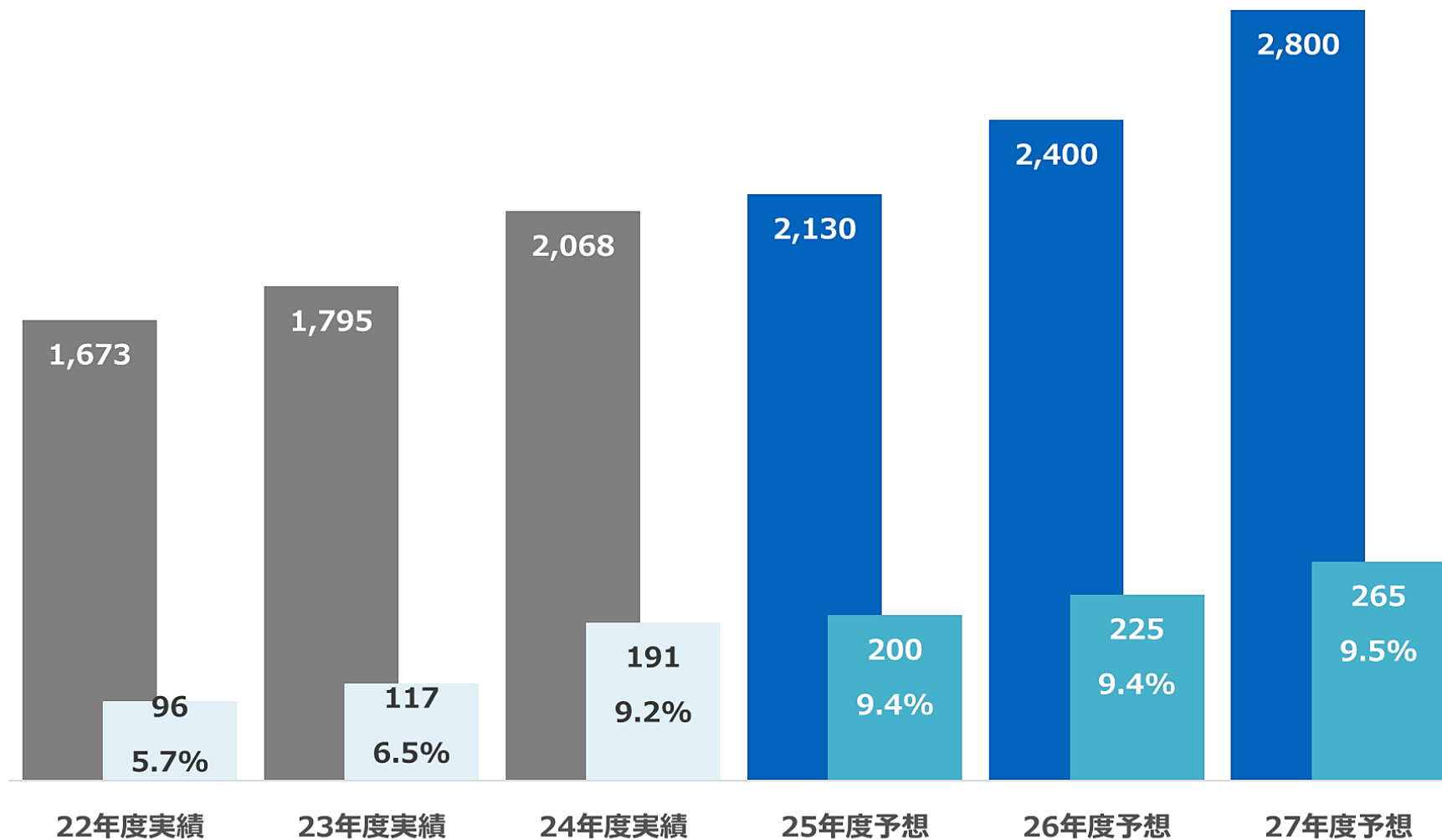
4

今後の方針

中期経営計画 概要

(単位：億円)

■ 売上 ■ 営業利益



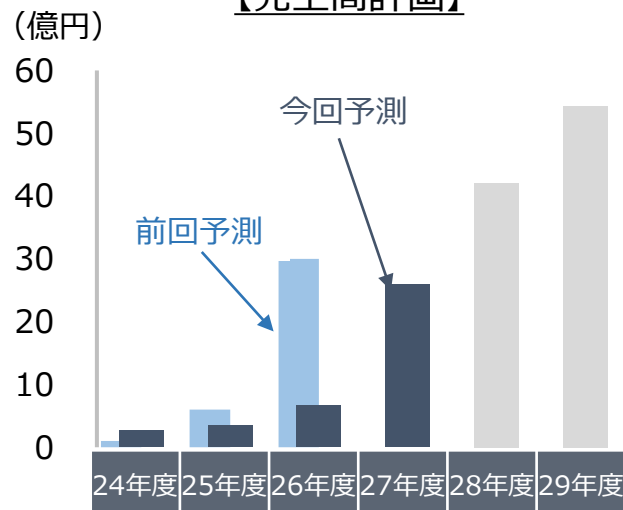
為替	136.00	145.31	152.57	140	140	140
投資額	174	199	298	510	350	250

PKG事業について

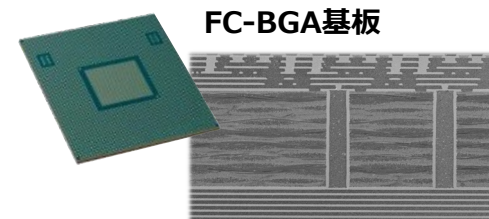
石巻第2工場



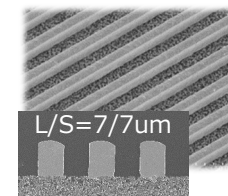
【売上高計画】



生産品目 FC-BGA基板



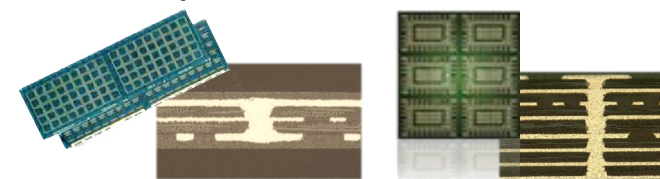
- ◆市況影響により量産立ち上がり計画が鈍化。
- ◆開発試作案件は堅調。
- ◆次世代高周波材対応、多段化・細線化開発加速。



生産品目 各種PKG基板

メモリー/センサー

RFモジュール

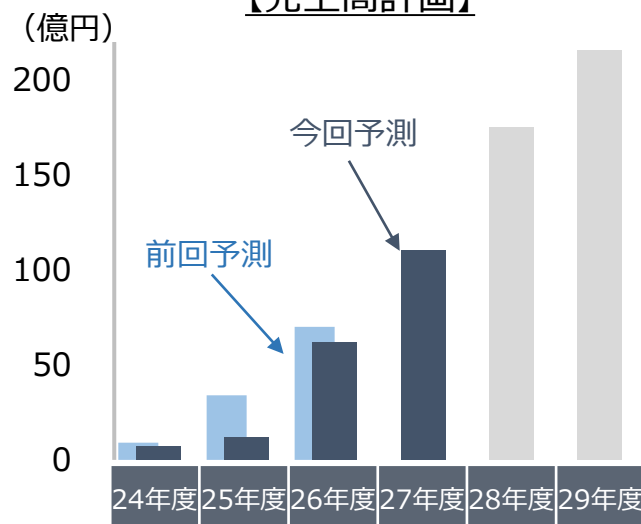


- ◆メモリー市況影響により大型量産案件が遅延。
- ◆各種センサーモジュール基板の量産開始。
- ◆今期からのメモリーPKG基板の量産と更なる新規ビジネス獲得に向け認定取得を加速。

ベトナム第3工場



【売上高計画】



天童工場の状況

天童ソーラーパーク



《天童工場》

大規模ビルドアップエコスマート工場



《河北工場》

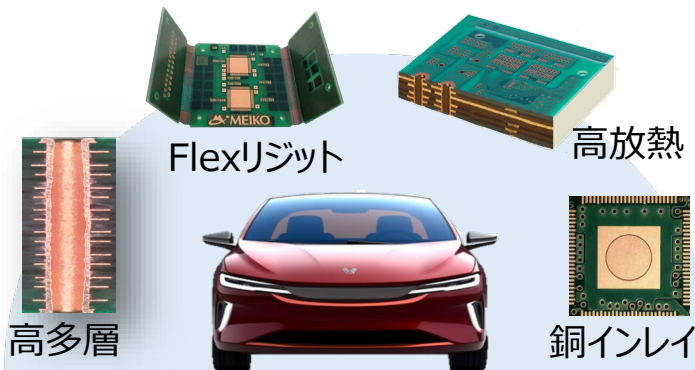


開発品量産工場

既存工場
との差別化

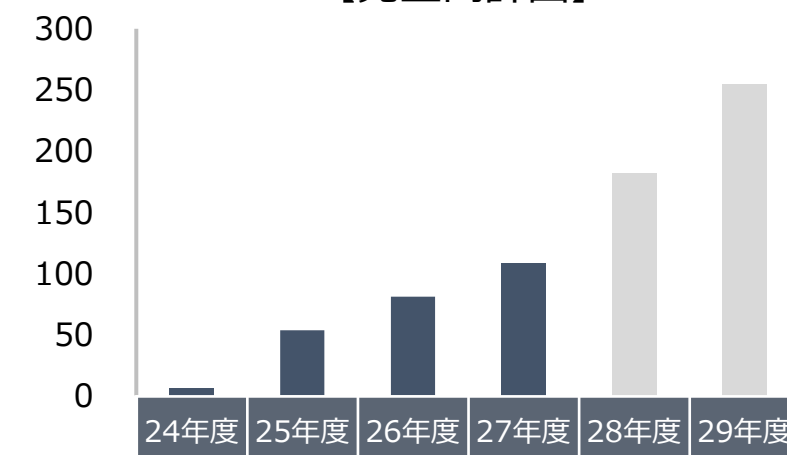
《天童開発センター》

- ・産学連携開発案件強化
- ・米沢ODM事業との連携
- ・新規開発商品の量産化



(億円)

【売上高計画】



ベトナム第4工場

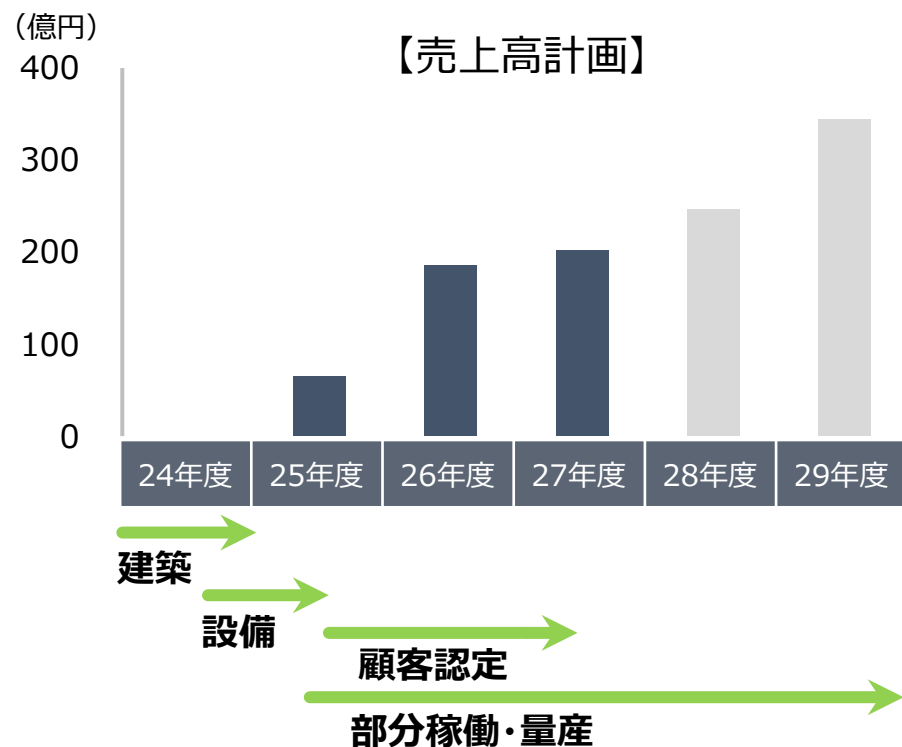
ベトナム第2工場は既にフル操業であり、7月からの部分稼働を計画し、今後の需要増に備える。

ベトナム第4工場 事業概要

延床面積 約60,000㎡ (15,000㎡×4F)

投資規模 約250億円

事業内容 第2工場(PCB)のキャパ補完
高多層・高密度HDI基板
メモリーモジュール基板

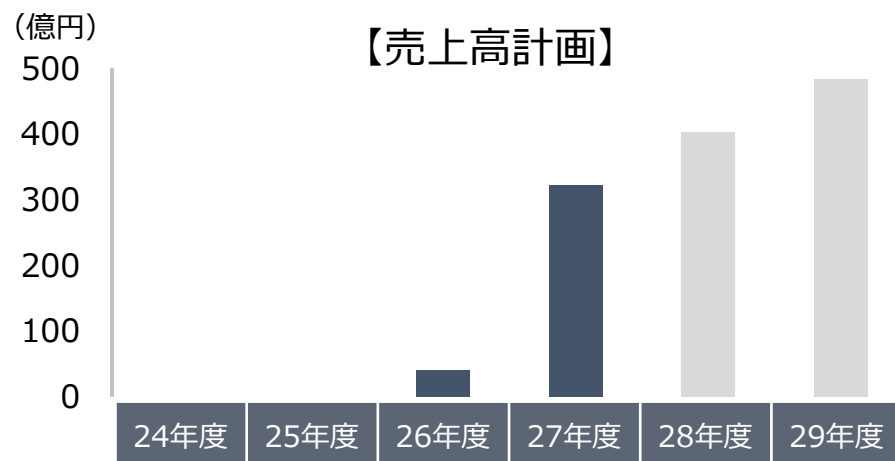


ホアビン工場

今後のAI機器需要増を受け、電力の優位性などを踏まえ、ホアビンでの最先端工場の立ち上げを実施中。

ホアビン工場 事業概要

敷地面積	約93,000m ²
延床面積	約60,000m ² （第1工場）
投資規模	約500億円（第1工場）
事業内容	中高多層・高密度ビルドアップ基板

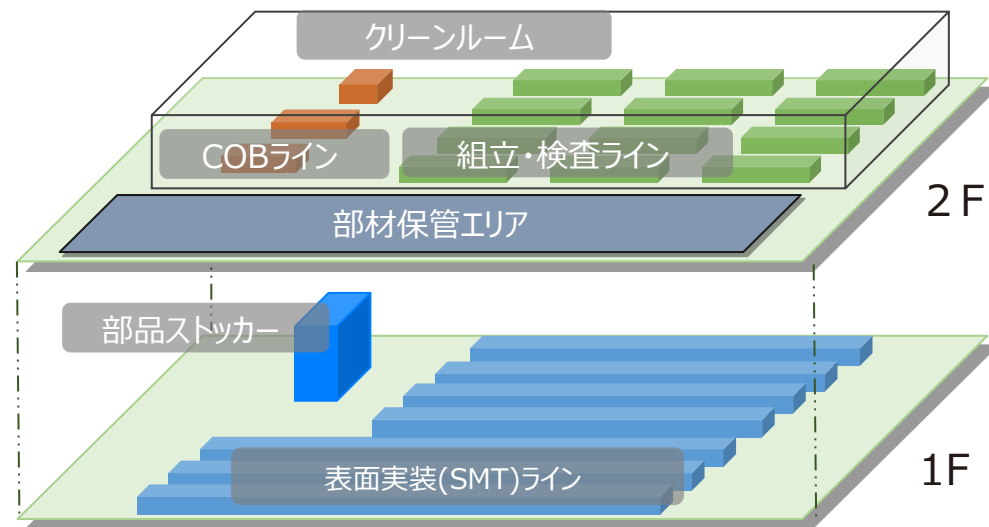
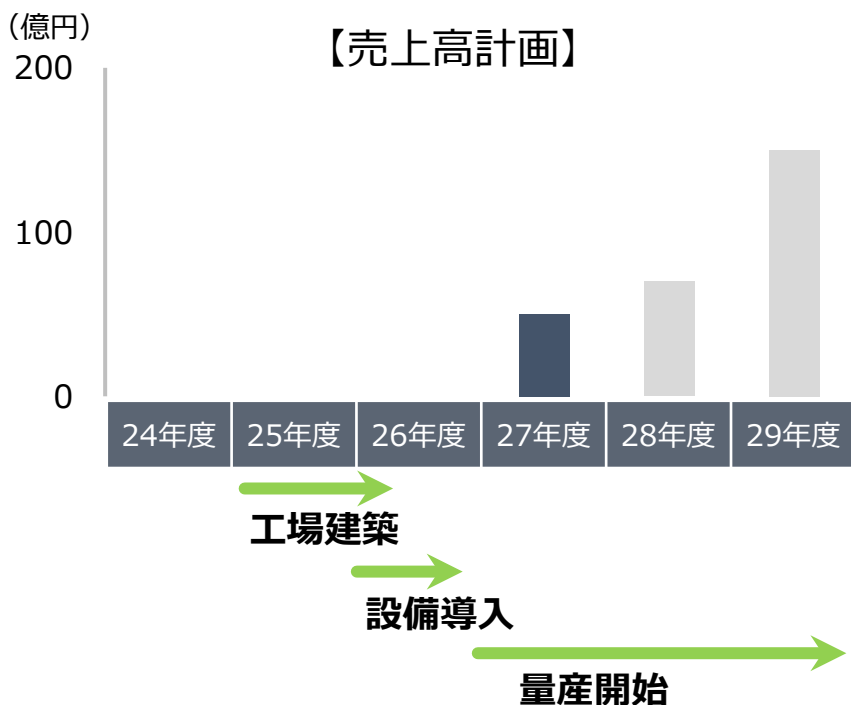
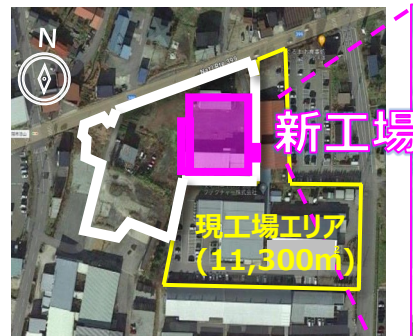


南陽工場 EMS工場増築

従来のEMS企業では対応できない、先進的なODM型の製品開発～生産を幅広く実現

南陽工場 事業概要

敷地面積	約11,300㎡+7,600㎡(今回取得)
延床面積	約4,700㎡ (新工場)
投資規模	約25億円
事業内容	自動運転などに必要な測距装置等



- ・数ミクロン～十数ミクロンでの高精度な位置決めが必要な半導体実装対応
- ・光学ユニットを高精度に位置決めするためのアクティブアライメント調整技術